

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

191-2T

Première édition
First edition
1996-12

Dix-huitième complément à la Publication 191-2 (1966)

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs**

iTeh **STANDARD PREVIEW**
Partie 2:
Dimensions
(standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bed98f56-86b7-44f9-be8b-13f29f0ce8c0/iec-60191-2t-1996>

Eighteenth supplement to Publication 191-2 (1966)

**Mechanical standardization of semiconductor
devices**

Part 2:
Dimensions

*Les feuilles de ce complément sont à insérer dans la
Publication 191-2*

*The sheets contained in this supplement are to be
inserted in Publication 191-2*



CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
191-2

Première édition
First edition
1996-12

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974),
F (1976), G (1978), H (1978), J (1980), K (1981),
L (1982), M (1983), N (1987), P (1988), Q (1990)
R (1995), S (1995) et/and T(1996)

Dix-huitième complément à la Publication 191-2 (1966)

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs**

iTeh **Partie 2:** STANDARD PREVIEW
Dimensions
(standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bcd78156-80b7-419-0c80-13f29f0ce8c0/iec-60191-2t-1996>

IEC 60191-2T:1996
Eighteenth supplement to Publication 191-2 (1966)

**Mechanical standardization of semiconductor
devices**

**Part 2:
Dimensions**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 191-2

Remplacer la page de titre existante par la
nouvelle page de titre.

Retirer la page 191 IEC 1 existante et la
remplacer par la nouvelle page 191 IEC 1.

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

191 IEC I-083B-a
191 IEC I-083B-b
191 IEC I-084F-a
191 IEC I-084F-b

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 191-2

Replace the existing title page with the
new title page.

Remove the existing page 191 IEC 1 and
insert in its place the new page 191 IEC 1.

Chapter I:

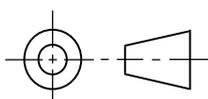
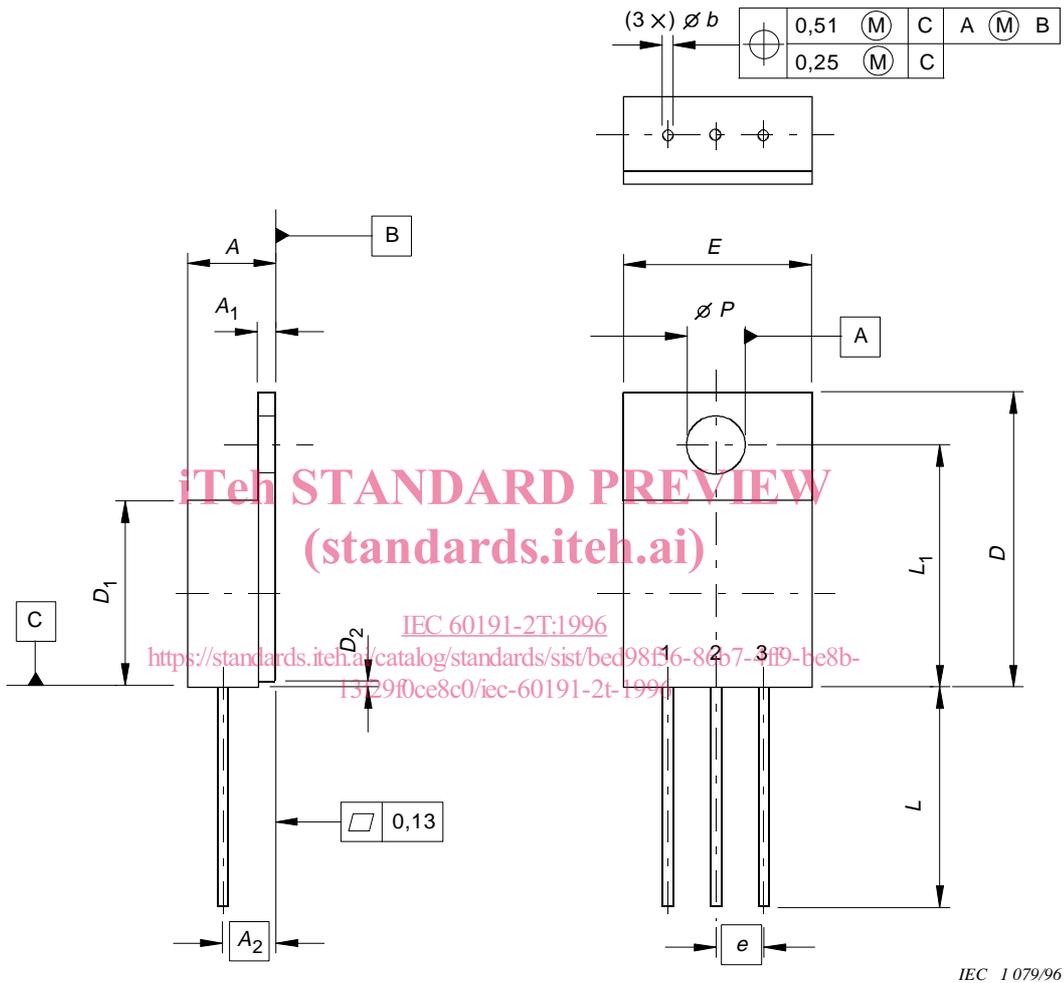
Add the following new sheets:

191 IEC I-083B-a
191 IEC I-083B-b
191 IEC I-084F-a
191 IEC I-084F-b

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60191-2T:1996](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bed98f56-86b7-4ff9-be8b-13f29f0ce8c0/iec-60191-2t-1996)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bed98f56-86b7-4ff9-be8b-13f29f0ce8c0/iec-60191-2t-1996>

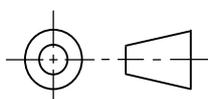


Famille de boîtiers à radiateur monté sur le flanc (sorties périphériques) avec une distance de 0,100 inches entre broches
 Flange mounted header family (peripheral terminals) 0,100 inch lead spacing

Date: 1996

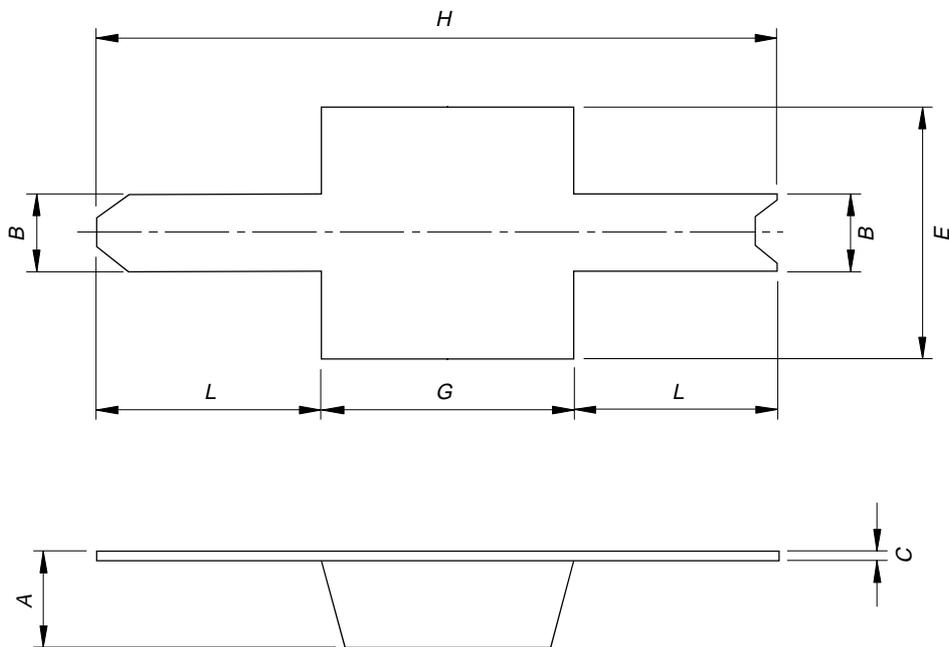
Toutes les dimensions sont données en millimètres All dimensions in millimetres								
	Type AA		Type AB		Type AC		Type AD	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
<i>A</i>	4,83	5,33	4,83	5,33	4,83	5,33	4,83	5,33
<i>A</i> ₁	0,89	1,14	0,64	0,89	0,64	0,89	0,89	1,14
<i>A</i> ₂	3,05*		2,79*		2,79*		3,05*	
$\varnothing b$	0,64	0,89	0,89	1,14	0,64	0,89	0,89	1,14
<i>D</i>	16,38	16,89	16,38	16,89	16,38	16,89	16,38	16,89
<i>D</i> ₁	10,41	10,92	10,41	10,92	10,41	10,92	10,41	10,92
<i>D</i> ₂	–	0,97	–	0,51	–	0,97	–	0,97
<i>e</i>	2,54*		2,54*		2,54*		2,54*	
<i>E</i>	10,41	10,67	10,41	10,92	10,41	10,67	10,41	10,67
<i>L</i>	12,70	19,05	12,70	14,73	12,70	19,05	12,70	19,05
<i>L</i> ₁	13,39	13,64	13,21	13,72	13,39	13,64	13,39	13,64
$\varnothing P$	3,56	3,81	3,56	3,81	3,56	3,81	3,56	3,81

* Position exacte



Famille de boîtiers à radiateur monté sur le flanc (sorties périphériques) avec une distance de 0,100 inches entre broches
Flange mounted header family (peripheral terminals) 0,100 inch lead spacing

Date: 1996



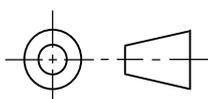
IEC 1080/96

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60191-2T:1996

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bed98f56-86b7-4ff9-be8b-13f29f0ce8c0/iec-60191-2t-1996>

Référence Reference	Type 1		Type 2		Notes
	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Max. mm	
A	–	0,05	–	0,05	1
B	0,08	0,14	0,08	0,14	2
C	0,003	–	0,003	–	3
E	0,25	0,32	0,165	0,30	
G	0,25	0,32	0,21	0,30	
H	0,78	0,84	0,65	0,72	
L	0,22	0,32	0,17	0,25	



Diodes hyperfréquences
à sorties à poutres
Microwave beam lead diode

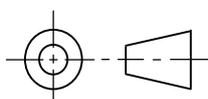
Date: 1996

- | | |
|--|--|
| <p>1 La valeur de cette dimension est déterminée par les tolérances du procédé, cependant elle ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée.</p> <p>2 Les extrémités des broches sont formées en vue de leur identification, la sortie en pointe est la cathode et la sortie crantée est l'anode. Le degré de mise en forme dépend de la tolérance du procédé de découpe de la sortie.</p> <p>3 La valeur minimale indiquée de cette dimension est l'épaisseur minimale de broche requise pour répondre aux exigences de solidité des sorties.</p> | <p>1 The value of this dimension is determined by process tolerances, however, it will not exceed the maximum value quoted.</p> <p>2 The ends of the leads are shaped for identification purposes, the "pointed" lead is the cathode and the "notched" lead the anode. The degree of shaping is dependent upon the tolerances of the etching process used to shape the lead.</p> <p>3 The minimum value of this dimension quoted is the minimum thickness of lead required to meet lead strength requirements.</p> |
|--|--|

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

IEC 60191-2T:1996

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bed98f56-86b7-4ff9-be8b-13f29f0ce8c0/iec-60191-2t-1996>



Diodes hyperfréquences
à sorties à poutres
Microwave beam lead diode

Date: 1996

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60191-2T:1996](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bed98f56-86b7-4ff9-be8b-13f29f0ce8c0/iec-60191-2t-1996)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bed98f56-86b7-4ff9-be8b-13f29f0ce8c0/iec-60191-2t-1996>

ICS 31.080.01
